



Telink

使用手册

TL3228X 开发板

UM-TL3228X-C3

Ver 1.0.2

2026/05/09

关键词

TL3228X, Bluetooth[®] LE, Zigbee, Thread, Matter, 2.4 GHz

摘要

本文档为泰凌多标准无线芯片 TL3228X 开发板使用手册。主要介绍了开发板框图、开发板特性、各种外设接口和详细的功能描述。

Published by
Telink Semiconductor

10-11/F, Building 1, 61 Shengxia Road,
Pudong District, Shanghai, China 201203

© Telink Semiconductor
All Rights Reserved

Legal Disclaimer

This document is provided as-is. Telink Semiconductor reserves the right to make improvements without further notice to this document or any products herein. This document may contain technical inaccuracies or typographical errors. Telink Semiconductor disclaims any and all liability for any errors, inaccuracies or incompleteness contained herein.

Copyright © 2026 Telink Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.

Information

For further information on the technology, product and business term, please contact Telink Semiconductor Company (www.telink-semi.com).

For sales or technical support, please send email to the address of:

telinksales@telink-semi.com

telinksupport@telink-semi.com

修订历史

版本	修订说明
1.0.0	初次发布
1.0.1	更新开发板图片
1.0.2	新增 Chapter 4 认证声明

目录

1 概述	6
1.1 框图	7
1.2 开发板特性	9
1.3 套件清单	9
1.4 开发板实物图	10
1.5 连接器	12
1.6 LED	14
1.7 按键	16
1.8 Switch开关	18
2 功能描述	19
2.1 供电	19
2.2 Debug接口	20
2.3 电流测试	21
2.4 RF测试	23
2.5 GPIO接口	23
2.6 外设接口 - USB转UART	26
2.7 外设接口 - BEVK模块	27
2.8 外设接口 - USB Type-C (HS)	29
2.9 外设接口 - 32.768KHz晶振	29
2.10 外设接口 - DMIC	29
2.11 外设接口 - Flash	30
2.12 外设接口 - IR	30
2.13 上行通路接口	31
2.14 下行通路接口	32
3 相关文档	33
4 认证声明	34
4.1 FCC Statement	34

图片

Figure 1-1 开发板顶视图	7
Figure 1-2 开发板底视图	8
Figure 1-3 开发板实物的顶视图	10
Figure 1-4 开发板实物的底视图	11
Figure 1-5 开发板正面的连接器	12
Figure 1-6 开发板背面的连接器	13
Figure 1-7 开发板正面的LED灯	14
Figure 1-8 开发板正面的按键	16
Figure 1-9 开发板正面的开关	18
Figure 2-1 电源供电路径	20
Figure 2-2 开发板Debug接口	21
Figure 2-3 芯片3V3支路	22
Figure 2-4 芯片1V2支路	22
Figure 2-5 芯片J7和J8所有管脚	26
Figure 2-6 BEVK模块	27
Figure 2-7 EVK选择	28
Figure 2-8 安装驱动和选择芯片	28
Figure 2-9 差分AMIC和LINE-IN上行通路的关系	31
Figure 2-10 下行通路的连接关系	32